

COIN系列一元红外芯

红外产品轻量化的新方法



COIN系列一元红外芯，采用高芯科技晶圆级探测器，配备高性能信号处理电路以及图像处理算法，可提供各种业界标准接口和全系列光学镜头，利于OEM客户进行二次开发，适用于各领域红外热成像仪的开发及集成。



“业界最小尺寸及重量”

■ 尺寸20mm×20mm×10.4mm，重量 < 8g。

“图像细节丰富，血管清晰可见”

■ NETD < 40mK;
■ 非均匀性校正、智能图像增强、自适应动态范围压缩。

“快速集成”

■ DVP/LVDS多种模式图像输出接口，raw/YUV图像数据输出，串口控制。

产品型号	COIN212/R	COIN612/R	COIN417/R
探测器性能指标			
分辨率	256×192	640×512	400×300
像元间距	12μm	12μm	17μm
响应波段	8~14μm		
NETD	< 40mK		
图像处理			
帧频	25Hz/30Hz/50Hz/60Hz		
开机时间	<3秒		≤10秒
模拟视频	PAL/NTSC		
数字视频	RAW/YUV/BT656		
调光	线性/直方图/混合三种模式		
电子变焦	1~8倍无极放大，放大倍率步长为1/8		
图像显示	黑热 / 白热 / 伪彩色		
图像方向	水平/垂直/对角线翻转	水平	水平/垂直/对角线翻转
图像算法	非均匀性校正 (NUC)，自适应动态范围压缩 (AGC)，智能图像增强 (IDE)，数字降噪		
电气特性			
标准对外接口	30pin_HRS接口	50pin_HRS接口	
通讯方式	RS232-TTL, 115200bps		
工作电压范围	3.5~5.5V		
典型功耗	<0.4W	<0.75W	<1.1W
测温功能			
测温工作温度范围	-10°C ~ 50°C		
测温范围	-20°C~150°C, 100°C~550°C		
测温精度	±3°C 或 ±3% (取最大值)		
SDK	测温型产品可提供ARM端/Windows端/Linux端SDK，实现全屏测温		
物理特性			
尺寸(mm)	20×20×10.4 (含镜头)	25.4×25.4×14.1 (含快门)	25.4×25.4×14.1 (含快门)
重量	7.5g±0.5g (含镜头)	机芯: 13g±0.5g (含快门) 机芯+8.8mm镜头: 22.4g±0.5g 机芯+13mm镜头: 41g±0.5g 机芯+19mm镜头: 43.9g±0.5g	13g±0.5g(不含镜头)
环境适应性			
工作温度	-40°C ~ +70°C		
存储温度	-45°C ~ +85°C		
湿度	5%~95%，无冷凝		
振动	随机振动5.35grms,3轴向		
冲击	半正弦波, 40g/11ms,3轴6向		
光学镜头			
可选配镜头	定焦无热化: 3.2mm	定焦无热化: 8.8mm/13mm 19mm	定焦无热化: 9.7mm/15mm 19mm

武汉高芯科技有限公司

400-027-0198

marketing@gst-ir.com

www.gst-ir.com

湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号,430205



规格如有变更，恕不另行通知